

公司代码：688591

公司简称：泰凌微

泰凌微电子（上海）股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案为：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 240,000,000 股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,757,799 股后的股本 238,242,201 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 17,391,680.67 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.94%；

2、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司可参与本次分配的总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	泰凌微	688591	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

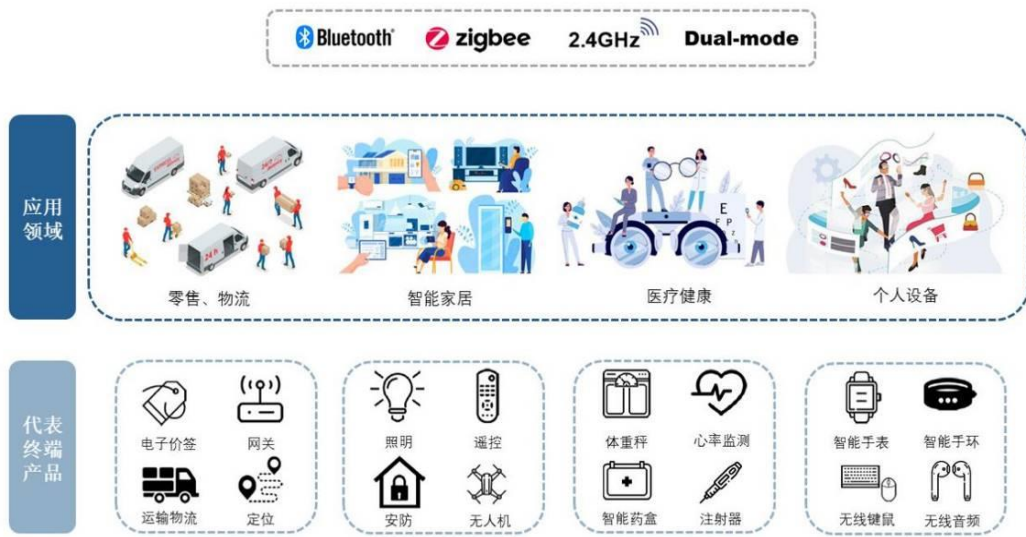
联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李鹏	马军
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1500号3幢	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1500号3幢
电话	021-50653177	021-50653177
电子信箱	investors_relation@telink-semi.com	investors_relation@telink-semi.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

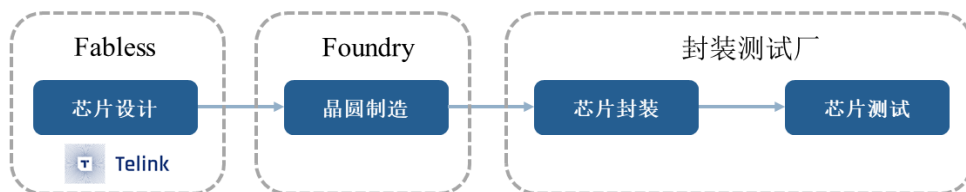
公司的主要业务是低功耗无线物联网芯片的研发、设计与销售，主要聚焦于低功耗蓝牙、Zigbee、Matter 等短距无线通讯芯片产品；在私有 2.4G 芯片、蓝牙音频芯片也有长期的技术积累和产品布局。公司的产品广泛应用于电脑外设、智能家居、智能硬件、智能工业系统、智能商业系统等领域。公司产品的应用领域广泛，客户行业分散。



公司的产品被大量国内外一线品牌所采用，包括谷歌、亚马逊、小米等物联网生态系统；罗技、联想等一线计算机外设品牌；创维、长虹、海尔等一线电视品牌；JBL、Sony 等音频产品品牌；欧瑞博、绿米等智能家居品牌。和一线品牌的长期合作，体现了公司在产品性能上的领先，以及产品的高品质和服务的高质量，构成了公司的竞争优势和商业壁垒。

(二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业，采用 Fabless 模式，致力于集成电路的设计、研发和销售，将晶圆制造、封装测试等环节委托给专业的晶圆制造厂商和封装测试厂商。公司采用的经营模式系基于行业特点和自身实际情况综合确定，有助于公司持续稳健经营。报告期内公司合作的晶圆制造厂商主要为中芯国际、台积电和华润上华，合作的存储芯片制造厂商主要为兆易创新、普冉半导体等，合作的封装测试厂商主要为华天科技、甬矽电子、震坤科技、通富微电等，均为知名的晶圆制造和封装测试厂商。



按照集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司芯片后进行二次开发、设计或加工为模组/PCBA 或加工至终端产品成品的客户，该等客户包括方案商、模组厂以及终端产品厂商或其代工厂；经销客户多为电子元器件分销商。公司的直销模式和经销模式，均为买断式销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家专业的集成电路设计企业，主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”之“新兴软件和新型信息技术服务”之“集成电路设计”行业。

公司所属行业属于国家重点培育和发展的七大“战略性新兴产业”中的“新一代信息技术产业”，该行业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，是支撑国民经济和社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，也是我国进口依存度大、亟需提升国产化水平的产业，因此受到国家多项法规政策的扶持鼓励，对国民经济健康发展具有重要的战略意义。

（一）行业发展阶段及基本特点

在过去 25 年里，以 Wi-Fi、蓝牙、和 Zigbee 等为代表的短距离无线连接技术彻底改变了我们生活的世界。预计未来将形成一个庞大的互联设备生态系统。

这些技术自诞生以来都经历了重大变革，显著提高了性能、效率、可靠性、安全性和可扩展性，同时带来了额外的功能增强，使它们能够更好地为某些目标应用程序提供服务。以 Wi-Fi 为例，从单频段 2.4GHz 802.11b 及其几兆比特每秒 (Mbps) 的吞吐量到最新 802.11be (Wi-Fi 7) 通过三频段 (tri-band) 技术实现的超过 5G 比特每秒 (Gbps) 的吞吐量，有了非常大的变化。同样，蓝牙从经典形式的以音频为中心的技术演变为低功耗蓝牙 (LE) 形式的物联网 (IoT) 应用的领先低功耗无线技术，这些都进一步证明了短距离无线连接市场在过去几十年中的持续进步和扩张。

然而，连接设备市场的持续创新和增长取决于短距离无线连接技术的进一步发展。消费者和物联网应用的巨大多样性，使得单一技术无法满足每个市场的需求。同时，未来的用例将要求无线技术在几乎所有指标上进行进一步改进，这些包括吞吐量、延迟、鲁棒性、可靠性、功耗、范围、安全性、可扩展性、效率、尺寸、成本、互操作性、灵活性和部署密度等等。这些增强功能将使短距离无线技术能够在现有用例中实现更好的性能，开辟新的市场机会，并促进跨多个垂直领域的创新用户体验的发展。

结合起来，这种演变导致了竞争极其激烈的短距离无线技术格局，针对大量消费者和商业用例，具有多种不同的可行技术，每种技术都有自己的优点和缺点，针对大量消费者和商业用例。公司需要适应这些无线技术的发展趋势，推出支持相应技术功能的芯片和协议栈，以满足客户多样性的产品开发需求。

（二）技术门槛

低功耗：射频电流、睡眠电流、处理器效率是关键挑战。芯片设计需要优化电路结构以降低射频电流和睡眠电流，在不影响性能的情况下提高处理器效率，以延长电池寿命。

射频性能：发射功率和接收灵敏度是射频性能的关键指标。芯片需要在保持良好射频连接的同时，尽可能降低功耗，以满足物联网设备对长距离通信和稳定连接的需求。

高集成度：芯片需要在尽可能小的尺寸内实现高度集成，以便吸收外部器件并增加新功能。这要求芯片设计具备良好的可扩展性和灵活性，能够满足不断变化的物联网应用需求。

端到端超低延迟：满足 ms 级延迟的需求是关键挑战，尤其是对于高性能设备。芯片需要优化通信协议和处理算法，以实现端到端的超低延迟，从而提供快速响应的用户体验。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在所处行业的多个领域拥有突出优势，地位稳固。公司的蓝牙低功耗 SoC 芯片长期位于市场的首要位置，成为全球第一梯队的代表之一。在 Zigbee 领域，公司是出货量最大的本土 Zigbee 芯片供应商，并稳居全球前列，在本地和国际市场上有强劲竞争实力。此外，公司的 Thread 和 Matter SoC 芯片紧跟最新的协议标准，在国际头部芯片供应商中占据一席之地。公司还在 2.4G 私有协议 SoC 领域取得领先地位，特别是在键鼠和 ESL 为代表的主要应用市场。在无线音频 SoC 方面，公司支持多种无线音频技术，包括最新的蓝牙低功耗音频技术，其芯片已成功进入国际头部品牌的产品线。

除此之外，在垂直应用市场中也建立了稳固的市场地位。在射频遥控器市场，公司芯片凭借多年的技术积累和市场验证占据了全球相当重要的份额；在 ESL 市场，公司提供高性价比的芯片和灵活的技术方案，出货量逐年增长，并处于国内龙头地位；并且在细分音频产品领域具备独

特的市场优势，特别是在超低延迟和多模共存音频设备方面。这些领域优势的叠加使得该公司在无线通信领域具备广泛的市场影响力和竞争实力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

以智能家居为代表的物联网应用，在过去几年取得了长足的发展，尤其是底层技术已经日趋成熟，形成了包括蓝牙、Zigbee、Wi-Fi、Thread 在内的几个主要行业标准规范。从发展阶段来看，物联网已经解决了基本的连接问题，并在此基础上实现了对各类设备的远程灵活控制及数据监测。但这距离物联网最终能够实现的终极价值还存在很大的差距，在向下一阶段更智能化的用户体验演进的过程中，仍有几个关键问题需要解决。就此，业界也已经就阻碍市场进一步渗透的关键因素达成了共识，其中互联互通和安全性无疑是亟待解决的最重要的两个问题。此外，还有边缘端的人工智能的普及。2023 年是物联网具有里程碑意义的一年，因为国内外对智能产品互联互通的重要标准都陆续发布，这包括了国内的 OLA 标准和国外的 Matter 标准，目的都是解决产品在应用层无缝互操作的问题，支持各种底层连接标准。这对于厂商和消费者都具有积极的意义，将有助于解决目前困扰行业上下游的产品孤岛化的困局，加速智能物联向生活/生产的渗透。此外，安全性毋庸置疑将会成为未来物联网产品的基本功能。凭借底层软硬件技术在安全性方面不断提升以及更安全的产品/方案的推出，物联网应用也将会进一步加速在各行各业的普及。

此外，为了进一步提升对特定应用场景的支持，以蓝牙为代表的现有无线通信标准也在不断推陈出新，同时也涌现出了以星闪技术为代表的全新的无线通信标准。这些增强功能将帮助这些技术支持下一代无线用例，这些用例需要改进吞吐量、范围、延迟、可靠性、功耗和可扩展性等关键指标。与此同时，这些技术在重叠领域内不断创新。这不仅包括吞吐量和可靠性的增强，还包括提供高精度定位的能力、对安全测距、联合通信和传感的支持，以及对新兴环境物联网市场的日益增长的支持。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	2,429,901,789.73	993,568,144.87	993,560,967.04	144.56	965,323,340.13
归属于上市公司 股东的净资产	2,341,382,866.11	928,142,207.73	928,152,698.44	152.27	876,552,779.21
营业收入	636,091,867.00	609,299,456.38	609,299,456.38	4.40	649,524,738.88
归属于上市公司 股东的净利润	49,771,753.28	49,768,847.97	49,785,556.04	0.01	95,007,709.40
归属于上市公司 股东的扣除非 经常性	22,905,990.11	34,788,101.16	34,804,809.23	-34.16	74,552,201.91

损益的净利润					
经营活动产生的现金流量净额	150,949,854.64	23,126,848.37	23,126,848.37	552.70	9,342,657.42
加权平均净资产收益率(%)	3.53	5.52	5.52	减少1.99个百分点	11.51
基本每股收益(元/股)	0.25	0.28	0.28	-10.71	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.28	0.28	-10.71	0.53
研发投入占营业收入的比例(%)				增加4.50个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	146,195,028.75	172,600,992.48	157,327,148.66	159,968,697.11
归属于上市公司股东的净利润	8,351,413.55	20,261,739.32	8,971,247.27	12,187,353.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,952,849.23	17,359,535.64	7,003,883.98	-8,410,278.74
经营活动产生的现金流量净额	6,656,139.88	17,412,434.39	59,387,165.28	67,494,115.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,984
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,320
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）								不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）								不适用
前十名股东持股情况								
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	包 含 转 融 借 出 份 限 股 数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
国家集成电路产业 投资基金股份有限 公司	0	21,488,400	8.95	21,488,400		无	0	国 有 法人
北京华胜天成科技 股份有限公司	0	17,861,940	7.44	17,861,940		无	0	境 内 非 国 有 法 人
上海芯狄克信息科 技合伙企业（有限合 伙）	0	14,530,320	6.05	14,530,320		无	0	其他
上海芯析企业管 理合伙企业（有限合 伙）	0	12,885,300	5.37	12,885,300		无	0	其他
北京中关村并购母 基金投资管理中心 （有限合伙）—北京 中关村并购母基金 投资中心（有限合 伙）	0	9,228,960	3.85	9,228,960		无	0	其他
盛文军	0	7,546,320	3.14	7,546,320		无	0	境 内 自 然 人
上海浦东新兴产业 投资有限公司	0	6,275,700	2.61	6,275,700		无	0	国 有 法人
上海凌析微管理咨 询合伙企业（有限合 伙）	0	5,526,000	2.30	5,526,000		无	0	其他

天津磐芯管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	5,328,900	2.22	5,328,900		无	0	其他
深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）—深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	5,118,840	2.13	5,118,840		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京华胜天成科技股份有限公司、盛文军、上海凌析微管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人王维航的一致行动人；上海芯狄克信息科技合伙企业（有限合伙）、上海芯析企业管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人王维航控制的企业；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

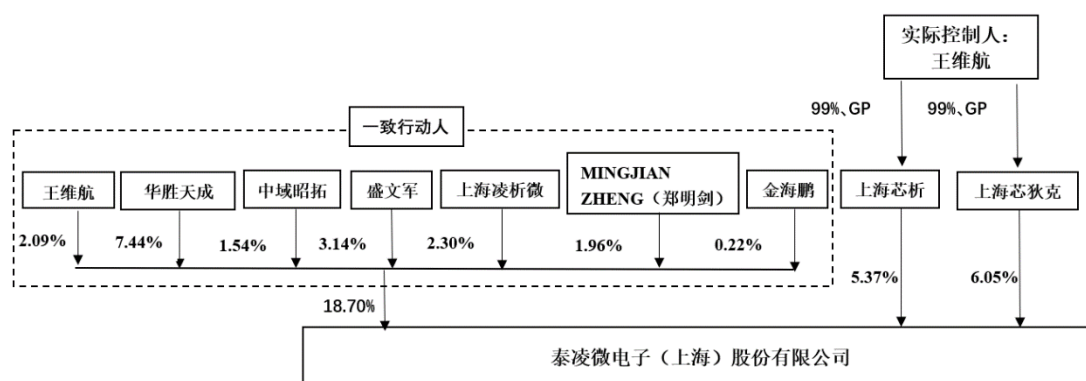
适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 6.36 亿元，较上年同期增长 4.40%；报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 4,977.18 万元，与上年基本持平；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,290.60 万元，同比下降 34.16%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用